



中华人民共和国国家标准

GB/T 17473.7—2022

代替 GB/T 17473.7—2008

微电子技术用贵金属浆料测试方法 第7部分：可焊性、耐焊性测定

Test methods of precious metals pastes used for microelectronics—
Part 7: Determination of solderability and solder leaching resistance

2022-03-09 发布

2022-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 17473《微电子技术用贵金属浆料测试方法》的第 7 部分。GB/T 17473 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：固体含量测定；
- 第 2 部分：细度测定；
- 第 3 部分：方阻测定；
- 第 4 部分：附着力测试；
- 第 5 部分：黏度测定；
- 第 6 部分：分辨率测定；
- 第 7 部分：可焊性、耐焊性测定。

本文件代替 GB/T 17473.7—2008《微电子技术用贵金属浆料测试方法 可焊性、耐焊性测定》，与 GB/T 17473.7—2008 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了供测试选用基片的规定和要求(见 5.1,2008 年版的 3.1)；
- b) 删除了“最高使用温度为 1 000 ℃”(见 2008 年版的 4.2)；
- c) 更改了选用干燥设备的规定(见 6.4,2008 年版的 4.4)；
- d) 更改了浆料印刷图案面积的规定(见 7.2,2008 年版的 5.2)；
- e) 更改了焊料设定温度的规定(见 8.1.2,2008 年版的 5.5.1、5.6.1)；
- f) 更改了可焊性试验浸焊时间的规定(见 8.2.6,2008 年版的 5.5.6)；
- g) 更改了耐焊性试验浸焊时间的规定(见 8.3.2,2008 年版的 5.6.3)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本文件起草单位：贵研铂业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司。

本文件主要起草人：梁诗宇、李文琳、刘继松、朱武勋、向磊、田相亮、李江民、樊明娜、马晓峰。

本文件于 1998 年首次发布，2008 年第一次修订，本次为第二次修订。